(1) Veröffentlichungsnummer:

0 064 181

**A1** 

(12)

### EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 82103118.4

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: H 01 H 1/02

(22) Anmeldetag: 13.04.82

(30) Priorität: 27.04.81 DE 3116680

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 10.11.82 Patentblatt 82/45

84 Benannte Vertragsstaaten: AT DE FR GB IT NL SE (1) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München Postfach 22 02 61 D-8000 München 22(DE)

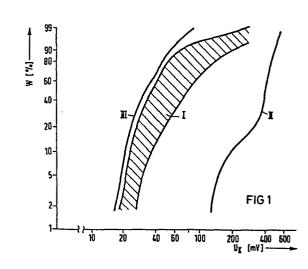
(72) Erfinder: Wilhelm, Manfred, Dr. Teutonenstrasse 23 D-8500 Nürnberg(DE)

(22) Erfinder: Rauter, Günther, Dipl.-Ing. Amberger Strasse 56a D-8451 Kümmersbruck(DE)

(72) Erfinder: Schultz, Ludwig, Dr. Hutweide 62 D-8520 Buckenhof(DE)

(54) Kontaktwerkstoff aus einer Kupferlegierung.

(57) Ein Kontaktwerkstoff für elektrische Kontakte, insbesondere von Niederspannungs- oder Installationsschaltgeräten, besteht aus einer niedriglegierten Kupferlegierung. Kontakte aus solchen Werkstoffen sollen insbesondere niedrigere Kontaktspannungen nach einer Vielzahl von Schaltvorgängen zeigen. Die Erfindung sieht hierzu vor, daß der Legierungspartner des Kupfers mindestens ein Element aus der Gruppe Antimon, Gallium, Germanium ist, wobei der Antimon-Gehalt zwischen 0,01 und 7 Atom-% bzw. der Gallium-Gehalt zwischen 0,5 und 20 Atom-% bzw. der Germanium-Gehalt zwischen 0,5 und 10 Atom-% liegen. Diese Kupferlegierung kann mindestens einen weiteren Legierungspartner enthalten, und zwar eine vorbestimmte Menge eines oder mehrerer Elemente aus der Gruppe Cadmium, Chrom, Kobalt, Palladium, Silizium.



P 0 064 181 A1

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin und München

Unser Zeichen VPA 81 P7531 E

5 Kontaktwerkstoff aus einer Kupferlegierung und Verfahren zu seiner Herstellung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Kontaktwerkstoff aus einer niedriglegierten Kupferlegierung, insbesondere 10 für Niederspannungs- und Installationsschaltgeräte. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung dieses Kontaktwerkstoffes.

Werkstoffe für elektrische Kontakte müssen zur Ver15 hinderung starker Erwärmung elektrisch und thermisch
gut leiten. Ihre mechanischen Eigenschaften wie z.B.
Härte, Festigkeit, elastisches Verhalten sind dem jeweiligen Anwendungszweck optimal anzupassen. Außerdem
sollte ihre Anfälligkeit gegenüber korrosiven Medien
20 gering sein. Im allgemeinen lassen sich nur auf verhältnismäßig edlen Werkstoffen Anlauf- und Zunderschichten und damit hohe Kontaktwiderstände vermeiden.
Darüber hinaus dürfen Kontaktwerkstoffe beim Schalten
weder kleben noch verschweißen, und ihr Abbrand sowie
ihre Materialwanderung sollten gering sein.

Diese und noch weitere, an gute Kontaktwerkstoffe zu stellende Anforderungen werden von Silber, seinen Legierungen sowie von Verbundwerkstoffen auf Silber30 basis dank hervorragender physikalischer und chemischer Eigenschaften in einem Maße erfüllt, daß diese Materialien in der Niederspannungstechnik eine breite Anwendung gefunden haben. Silber ist jedoch ein verhältnismäßig teures Material, so daß man bestrebt ist, es durch andere, kostengünstigere Materialien zu er-

### -2- VPA 81 P 7 5 3 1 E

setzen. Hierbei bieten sich Kupfer und seine Legierungen an (vgl. z.B. A.Keil: "Werkstoffe für elektrische Kontakte", Springer-Verlag, Berlin 1960, insbesondere Seiten 122 bis 143, oder D.Stöckel u.a.: "Werkstoffe für elektrische Kontakte", Kontakt & Studium Bd. 43, Expert Verlag, 7031 Grafenau 1/Württ., 1980). Die hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit des Kupfers, verbunden mit günstigen mechanischen Eigenschaften, tragbaren Kosten und im allgemeinen 10 guter Beschaffungsmöglichkeit werden von keinem anderen Kontaktmaterial erreicht. Wegen seines im Vergleich zum Silber unedleren Charakters, insbesondere seiner Oxidationsfreudigkeit, kann jedoch dieser Werkstoff in reiner Form vielfach nicht zur Fertigung von Kontaktstücken, 15 insbesondere für Niederspannungsschaltgeräte und Installationsschaltgeräte wie z.B. für Schütze, Hilfsschütze, Leistungsschalter oder Schutzschalter herangezogen werden. Zwar lassen sich durch Zulegierung bestimmter Elemente die Werkstoffeigenschaften dieser 20 Materialien wie z.B. das Oxidationsverhalten verbessern. Jedoch haben Kontakte aus Kupferlegierungen mit bekannten Legierungspartnern aus kostengünstigen Materialien bereits nach wenigen Schaltungen im allgemeinen einen verhältnismäßig hohen Kontaktwiderstand, so daß sie für Niederspannungsschaltgeräte oder Installations-25 schaltgeräte meistens nicht geeignet sind.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, einen Kontaktwerkstoff aus einer kostengünstigen Kupferlegie30 rung anzugeben, der einerseits im Vergleich zum reinen Kupfer wesentlich niedrigere Zunderraten zeigt und andererseits gleichzeitig zumindest annähernd ähnliche Kontakteigenschaften hat wie die bekannten, für Kontakte von Niederspannungs- und Installationsschaltgeräten verwendeten Silberlegierungen. Insbesondere soll ein verhältnismäßig niedriger Kontaktwiderstand gewähr-

### -3- VPA 81 P 7 5 3 1 E

leistet sein.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Legierungspartner des Kupfers mindestens ein

5 Element aus der Gruppe Antimon, Gallium, Germanium ist, wobei der Antimon-Gehalt zwischen 0,01 und 7 Atom-% bzw. der Gallium-Gehalt zwischen 0,5 und 20 Atom-% bzw. der Germanium-Gehalt zwischen 0,5 und 10 Atom-% liegen.

10

Die genannten Legierungspartner besitzen eine endliche Löslichkeit in festem Kupfer.

Die mit der Erfindung erreichten Vorteile sind insbesondere darin zu sehen, daß durch das Zulegieren
der genannten Stoffe zu dem Kupfer einerseits die
Korrosionsbeständigkeit des Kontaktwerkstoffs erhöht
wird und andererseits Kontakte mit diesen Legierungsmaterialien in Schaltversuchen einen tolerierbaren

20 Kontaktwiderstand zeigen. Da diese Kontaktwerkstoffe
im allgemeinen kostengünstiger als die bekannten
Silber-Legierungen sind, können sie somit vorteilhaft
als Ersatz für die bekannten Kontaktwerkstoffe auf
Silberlegierungsbasis dienen.

25

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des Kontaktwerkstoffs nach der Erfindung kann die Kupferlegierung
noch mindestens einen weiteren Legierungspartner enthalten. Dieser kann ein oder mehrere Elemente aus der
30 Gruppe Cadmium, Chrom, Kobalt, Palladium, Silizium,
sein, wobei der Cadmium-Gehalt zwischen 0,1 und
2 Atom-%, der Chrom-Gehalt zwischen 0,01 und 0,8
Atom-%, der Kobalt-Gehalt zwischen 0,1 und 1,8 Atom-%,
der Palladium-Gehalt zwischen 0,1 und 3 Atom-% und
35 der Silizium-Gehalt zwischen 0,5 und 10 Atom-% liegen.

#### -4- VPA 81 P 7 5 3 1 E

Der Anteil des weiteren Legierungspartners soll dabei höchstens gleich dem Anteil an Antimon oder Gallium oder Germanium sein.

- 5 Zur weiteren Erläuterung der Erfindung und deren in den Unteransprüchen gekennzeichneten Weiterbildungen wird auf die Tabelle und die Diagramme der Zeichnung Bezug genommen, aus denen Eigenschaften von Kontaktwerkstoffen nach der Erfindung zu entnehmen sind.
- 10 Dabei zeigt das Diagramm der Fig. 1 Häufigkeitskurven der Kontaktspannungen einiger binärer Legierungen nach der Erfindung. In dem Diagramm der Fig. 2 sind Kontaktspannungen für spezielle Kupfer-Germanium-Legierungen und in dem Diagramm der Fig. 3 sind
- 15 Häufigkeitskurven der Kontaktspannungen einiger ternärer Legierungen nach der Erfindung wiedergegeben.

In der nachfolgenden Tabelle sind Angaben über das Zunder- bzw. Korrosionsverhalten einiger binärer Kupferlegierungen nach der Erfindung im Vergleich zu reinem Kupfer zu entnehmen. Die genannten Legierungen können unter Verwendung chemisch reiner Ausgangsmaterialien unter Argon in einem Graphittiegel erschmolzen und bei Temperaturen zwischen 600°C und 950°C zur Vermeidung von Seigerungen getempert wer-25 den. Die homogenen Körper aus diesen Legierungen lassen sich nach gebräuchlichen Umformverfahren wie Walzen, Hämmern oder Drahtziehen zu Blechen, Drähten und Kontaktstücken verarbeiten. Entsprechende Bleche 30 dienten zur Prüfung der Korrosionsbeständigkeit. Die in der Tabelle in Mikrogramm pro Quadratzentimeter gemessene Gewichtszunahme 🛕 m der einzelnen Materialien ist nach Oxidation an Luft nach einer 24stündigen Wärmebehandlung bei 250°C zu erhalten.

11

#### VPA 81 P 7 5 3 1 E -5-

#### Tabelle

	$\Delta m \left[ \text{/ug / cm}^2 \right]$
	160 - 175
Sb 1,75	45 ·
Ga 1,75	32
Ge 0,2	36
Ge 6,0	20
	Sb 1,75 Ga 1,75 Ge 0,2 Ge 6,0

10

In der Tabelle sind die Anteile der jeweiligen Legierungszusätze zu dem Kupfer in Atom-% vermerkt. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, haben die Legierungen nach der Erfindung eine wesentlich geringere Zunder-

15 neigung als reines Kupfer.

Anhand der Kurven in dem Diagramm der Fig. 1 können Aussagen über den Kontaktwiderstand von Kontaktstücken aus Werkstoffen gemäß der Erfindung gemacht werden. 20 In diesem Diagramm ist auf der Abszisse die Kontaktspannung  $\mathbf{U}_{\mathbf{k}}$  in Millivolt angegeben, während auf der Ordinate die kumulative Häufigkeit W der an einem Schützkontakt gemessenen Kontaktspannung gemäß der sogenannten Weibull-Statistik aufgetragen ist. Dem Ausführungsbeispiel der Figur ist ein Schütz mit Kontakten zugrundegelegt, die unter einer mittleren Belastung von 45 A bei 110 V Wechselspannung unter ohmscher Last etwa 2000 mal geschaltet wurden.

In dem mit I bezeichneten Bereich des Diagramms liegen die Häufigkeitskurven von Kontaktspannungen an Kontakten aus Kupferlegierungen nach der Erfindung, wobei der Legierungsanteil an Antimon bzw. Gallium bzw. Germanium jeweils etwa zwischen 1,75 und 7 Atom-% 35 beträgt. Zum Vergleich ist in der Figur eine mit II

-6- VPA 81 P 7 5 3 1 E

bezeichnete Kurve eingetragen, welche die Häufigkeit der Kontaktspannungen an reinen Kupferkontakten angibt. Die mit III bezeichnete Häufigkeitskurve ergibt sich für Kontakte aus einem gebräuchlichen 5 Kontaktmaterial auf Silberbasis, hier für Silber-Cadmiumoxid mit einem Cadmiumoxidgehalt von 15 Volumen-%.

Dem Diagramm der Fig. 1 ist zu entnehmen, daß die
10 Kontaktspannungen der Werkstoffe und damit auch die
am Kontakt anfallenden Übertemperaturen Kontaktspannungen bzw. Kontakterwärmungen bisher gebräuchlicher Materialien zumindest weitgehend entsprechen .
Mit den genannten, verhältnismäßig kostengünstigen
15 Werkstoffen können somit teurere Kontaktwerkstoffe
auf Silberbasis ersetzt werden.

In Fig. 2 sind in einem Diagramm Kontaktspannungen angegeben, die an Kontakten aus binären Kupfer-20 Germanium-Legierungen mit unterschiedlicher Germanium-Konzentration zu messen sind. Dabei sind auf der Abszisse die Germanium-Konzentration in Atom-% und auf der Ordinate die Kontaktspannung  $\mathbf{U}_{\mathbf{k}}$  in m $\mathbf{V}$  für eine Häufigkeit von 50 % aufgetragen. Dem Ausführungs-25 beispiel der Figur sind Kontaktspannungen an Kontakten bei 45 A und 110 V Wechselspannung unter ohmscher Belastung nach 2000 Schaltungen der Kontakte zugrundegelegt. Wie aus dem Diagramm dieser Figur abzulesen ist, sind insbesondere bei Germanium-Konzentrationen 30 zwischen 3 und 7 Atom-%, vorzugsweise bei etwa 5 Atom-%, die Kontaktspannungen und somit die Kontaktwiderstände besonders niedrig. Diese Tatsache ist insofern überraschend, da der spezifische elektrische Widerstand der Legierungen bei einem Germanium-Gehalt von etwa **35** 5 Atom-% kein Minimum zeigt, sondern einen Wert von

#### -7- VPA 81 P 7 5 3 1 E

etwa 18 /u \Omega · cm annimmt. Dieser Widerstand ist größer als der einer Legierung mit einem unter 5 Atom-% liegenden Germaniumanteil. Hieraus läßt sich ersehen, daß ein niedriger Kontaktwiderstand auch mit Mate-rialien mit verhältnismäßig hohem spezifischen elektrischen Widerstand erreicht wird, wenn nur der Fremdschichtwiderstand niedrig ist (vgl. z.B. die genannten Bücher von A.Keil und D.Stöckel).

- 10 Bei den Ausführungsbeispielen in der Tabelle und den beiden Figuren wurde von Kontaktwerkstoffen ausgegangen, die aus einer binären Kupferlegierung bestehen. Gegebenenfalls können diesen Legierungen noch weitere Elemente hinzugefügt sein, so daß dann beispielsweise ternäre oder quaternäre Legierungen gebildet sind. Hiermit läßt sich z.B. das Korrosions-
- gebildet sind. Hiermit läßt sich z.B. das Korrosionsverhalten oder der Kontaktwiderstand gegenüber den
  binären Legierungen noch weiter verbessern. Als solche
  zusätzlichen Legierungsbestandteile sind insbesondere
  20 die folgenden Materialien geeignet:
  - Cadmium mit einem Gehalt zwischen 0,1 und 2 Atom-% oder Chrom mit einem Gehalt zwischen 0,01 und 0,8 Atom-% oder Kobalt mit einem Gehalt zwischen 0,1 und 1,8 Atom-% oder Palladium mit einem Gehalt zwischen
- 25 0,1 und 3 Atom-% oder Silizium mit einem Gehalt zwischen 0,5 und 10 Atom-%. Selbstverständlich kann als dritter Legierungsbestandteil auch ein Element aus der Gruppe Antimon, Gallium, Germanium innerhalb der im Zusammenhang mit den binären Legierungen genannte
- 30 Grenzen der Legierungsanteile ausgewählt werden. Der in Atom-% angegebene Anteil der zusätzlichen, dritten und/oder vierten Legierungsbestandteile ist dabei i.a. kleiner oder höchstens gleich dem zweiten Legierungsbestandteil an Antimon oder Gallium oder Germanium.
- 35 Einige Ausführungsbeispiele solcher ternärer, Germanium

## -8- VPA 81 P 7 5 3 1 E

enthaltender Legierungen sind den in dem Diagramm der Fig. 3 wiedergegebenen Kurven zugrundegelegt, wobei Meßbedingungen wie bei den Ausführungsbeispielen gemäß dem Diagramm der Fig. 1 gewählt sind. In dem 5 Diagramm der Fig. 3 ist auf der Abszisse die Kontaktspannung  $\mathbf{U}_{\mathbf{k}}$  in mV angegeben, während auf der Ordinate die kumulative Häufigkeit der zu messenden Kontaktspannungen aufgetragen ist. Als Kontaktmaterialien sind drei spezielle  $CuGe_{3-x}X_x$ -Legierungen mit x Atom-% als Ausführungsbeispiele ausgewählt, nämlich: CuGe2,5CoO,5 (Kurve a), CuGe2,5SbO,5 (Kurve b) und CuGe2,9Cr0,1 (Kurve c). Außerdem sind zum Vergleich das binäre CuGe3,0 (Kurve d) und ferner ein bekanntes Kontaktmaterial auf Silberbasis, nämlich AgCdO (Kurve e) aufgeführt. Aus dem Verlauf der Kurven a bis c in dem Diagramm ist ersichtlich, daß auch ternäre Kupferlegierungen Kontaktwiderstände aufweisen, die ohne weiteres in der Größenordnung von Kontaktmaterialien auf Silberbasis liegen. Einen besonders geringen Kontaktwiderstand haben die Legierungen mit Kobalt als drittem Partner (Kurve a).

Auch die genannten Zusätze zu den binären Kupfer-Antimon- oder Kupfer-Gallium-Legierungen ergeben ähnliche Kontaktspannungsverhältnisse.

Bei den genannten Ausführungsbeispielen von binären oder ternären Kupferlegierungen als Kontaktwerkstoffen gemäß der Erfindung wurde davon ausgegangen, daß diese Legierungen auf schmelzmetallurgischem Wege hergestellt sind. Es ist jedoch ebenso möglich, diese Legierungen pulvermetallurgisch herzustellen. Danach vird ein Gemisch aus Pulvernder entsprechenden Elemerte in dem gewünschten Konzentrationsverhältnis durch Anwendung von Druck und durch eine Wärmebehandlung, beispiels-

# -9- VPA 81 P 7 5 3 1 E

weise durch Strangpressen, verdichtet und so homogenisiert, daß durch Feststoffdiffusion die genannten Legierungen gebildet werden.

- 10 Patentansprüche
  - 3 Figuren

#### Patentansprüche

- Kontaktwerkstoff aus einer niedriglegierten Kupferlegierung, insbesondere für Niederspannungs- und Installationsschaltgeräte, dadurch gekenn- zeichnet, daß der Legierungspartner des Kupfers mindestens ein Element aus der Gruppe Antimon, Gallium, Germanium ist, wobei der Antimon-Gehalt zwischen 0,01 und 7 Atom-% bzw. der Gallium-Gehalt zwischen 0,5 und 20 Atom-% bzw. der Germanium-Gehalt zwischen 0,5 und 10 Atom-% liegen.
- Kontaktwerkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich nach anspruch 1, daß die Kupferlegierung mindestens einen weiteren Legierungspartner enthält, und zwar ein oder mehrere Elemente aus der Gruppe Cadmium, Chrom, Kobalt, Palladium, Silizium, wobei der Cadmium-Gehalt zwischen 0,1 und 2 Atom-% bzw. der Chrom-Gehalt zwischen 0,01 und 0,8 Atom-% bzw. der Kobalt-Gehalt zwischen 0,1 und 1,8 Atom-% bzw. der Palladium-Gehalt zwischen 0,1 und 3 Atom-% bzw. der Silizium-Gehalt zwischen 0,5 und 10 Atom-% liegen und wobei der Anteil des weiteren Legierungspartners höchstens gleich dem Anteil an Antimon oder
   Gallium oder Germanium ist.
- 3. Kontaktwerkstoff aus einer Kupfer-Germanium-Legierung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich n et durch einen Germanium-Gehalt der Legierung 30 zwischen 3 und 7 Atom-%.
  - 4. Kontaktwerkstoff nach Anspruch 3, gekenn-zeichnet durch einen Germanium-Gehalt der Legierung von etwa 5 Atom-%.

-11- VPA 81 P 7 5 3 1 E

5. Kontaktwerkstoff nach Anspruch 3 oder 4, da-durch gekennzeichnet, daß der Anteil des Germaniums teilweise durch Kobalt ersetzt ist.

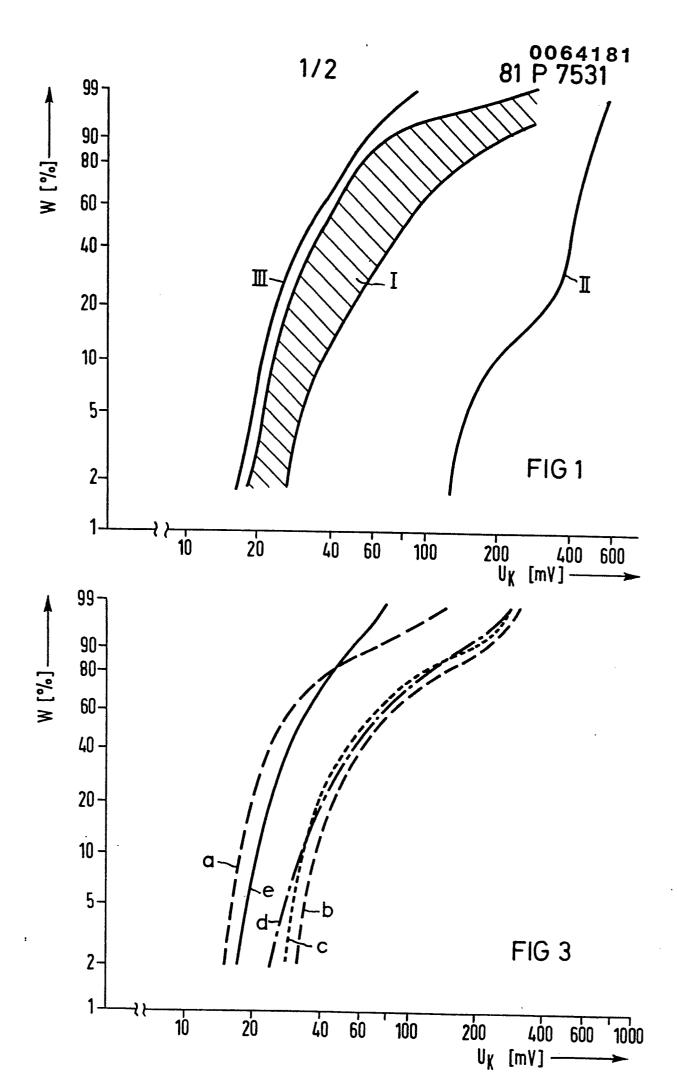
5

6. Verfahren zur Herstellung eines Kontaktwerkstoffs nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich net, daß die Legierung erschmolzen wird.

10

bildet wird.

- 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Erschmelzung unter Schutzgasatmosphäre vorgenommen wird.
- 15 8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dad urch gekennzeichnet, daß die erschmolzene Legierung einer thermischen Nachbehandlung unterzogen wird.
- 20 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich net, daß die erschmolzene Legierung bei Temperaturen zwischen 600°C und 950°C thermisch nachbehandelt wird.
- 25 10. Verfahren zur Herstellung eines Kontaktwerkstoffes nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dad urch gekennzeichnet, daß das Kupfer und der mindestens eine Legierungspartner in Pulverform zusammengepreßt werden und daß in einer thermischen 30 Behandlung die Legierung durch Feststoffdiffusion ge-



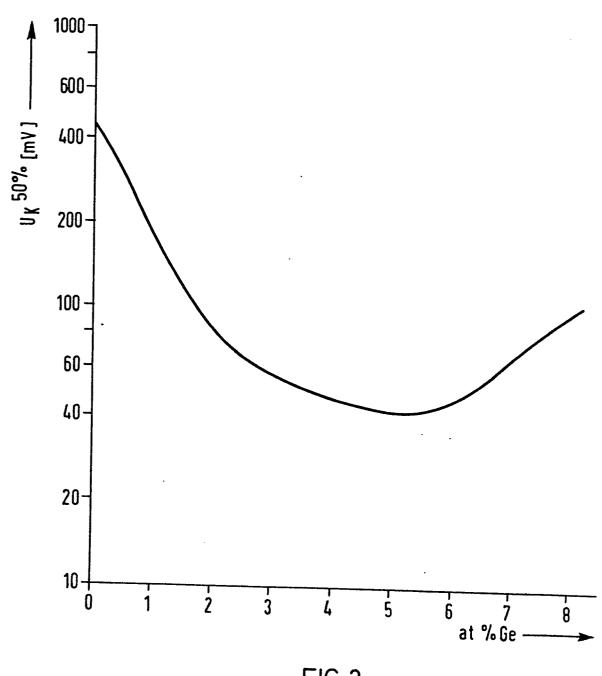


FIG 2



### **EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT**

EP 82 10 3118

<del></del> -		IGE DOKUMENTE		
ategorie		ts mit Angabe, soweit erforderlich, eblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Ci. *)
A	FR-A-2 428 904 TELEGRAPH) * Seite 4; Seite 2 924 238	•	1,6,7	но1 н 1/
A	FR-A-2 294 527 * Seiten 10-15 *	- (PLESSEY HANDEL)	1,2,7,	
A	GB-A-1 084 351 * Seite 2 *	- (MALLORY)	1,6	
Α	CHEMICAL ABSTRAC 1977, Seite 262, Columbus, Ohio, & JP - A - KIKINZOKU KOGYO * Zusammenfassun	Nr. 57137a, USA 77 30217 (TANAK K.K.) 07-03-197		
	Zusammenirassun	y		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CI.
A	CHEMICAL ABSTRAC 1977, Seite 671, Columbus, Ohio, & JP - A - KIKINZOKU KOGYO * Zusammenfassun	Nr. 149659e, USA 77 20288 (TANAK K.K.) 16-02-197		H 01 H 1/ H 01 H 11/
A	DE-B-1 289 991 * Spalten 1,2 *	- (SIEMENS)	1	
; X:v; Y:v	Recherchenort DEN HAAG  KATEGORIE DER GENANNTEN DON DESONDERER BEdeutung allein ton besonderer Bedeutung derselber	Abschlußdatum der Recher 16-08-1982  OKUMENTEN E: ä petrachtet noindung mit einer D: ir	JANSS  Iteres Patentdokum ach dem Anmelded n der Anmeldung ar	Prüfer ENS DE VROOM ment, das jedoch erst am o atum veröffentlicht worde ngeführtes Dokument angeführtes Dokument

P: Zwischenliteratur
T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze

stimmendes Dokument